

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В. Г. ПАДАЛКО, д.т.н. Ю. Е. НИКОЛАЕНКО,
А. Н. ВЫСОЦКИЙ, Н. В. КОНЧИЦ

Украина, г. Киев, Минпромполитики Украины
E-mail: nikola@industry.gov.ua

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 2007—2009 гг. В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Приведены основные технические характеристики научно-технической продукции, созданной в рамках Государственной программы развития промышленности на 2003—2011 годы в области микроэлектроники.

Выполнение работ, направленных на развитие наиболее конкурентоспособных направлений микроэлектроники в Украине, в рамках Государственной программы развития промышленности осуществляется по следующим направлениям:

- материалы для микроэлектроники;
- функциональная микроэлектроника;
- энергетическая микроэлектроника;
- сенсорная электроника;
- новое технологическое оборудование для микроэлектроники;
- интегральные схемы и полупроводниковые приборы.

Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполнялись в 2007—2009 годах, направлен на разработку конкурентоспособных изделий микроэлектроники на основе новых материалов, в частности карбиде кремния, фосфиде индия, на алмазе и т. п., что позволяет повысить рабочую температуру элементов до 400°C, уровень пробивного напряжения до 1000—2000 В, увеличить мощность генераторных модулей в 1,5—4 раза, повысить чувствительность радиолокационных устройств и т. п.

Материалы для микроэлектроники

НИР «Разработка технологии изготовления гетероструктур на основе InP для диодов Ганна», НПП «Карат», г. Львов.

Впервые в Украине разработаны физико-химические принципы технологии выращивания чистых эпитаксиальных слоев *i*-InP, являющихся активными слоями в составе гетероструктур для диодов Ганна с повышенной частотой генерации и высокой надежностью.

В основу проведения работы был положен предложенный в [1] способ получения высококачественных гетероструктур *n⁺*-InP/*n*-InP для диодов Ганна с низкой концентрацией дефектов и высокой подвижностью электронов в активном слое, основанный на применении комплексного легирования слоев InP

редкоземельными и изовалентными элементами Al и Yb в специально подобранных пропорциях. Эпитаксиальные слои InP, полученные таким способом, являются некомпенсированными и обладают низкой концентрацией фоновых примесей и высокой подвижностью электронов. При этом эффект «очистки» эпитаксиальных слоев проявляется при незначительных концентрациях легирующих элементов (Yb), что уменьшает вероятность загрязнения эпитаксиального слоя неконтролируемыми примесями из легирующего материала.

Полученные гетероструктуры *n⁺*-InP/*n*-InP по своим техническим характеристикам отвечают лучшим мировым образцам (табл. 1).

Таблица 1
*Характеристики гетероструктуры *n⁺*-InP/*n*-InP*

Концентрация электронов, см ⁻³	
в подложке <i>n⁺⁺</i> -InP	(3—5)·10 ¹⁸
в буферном слое <i>n_b⁺</i> -InP	(1—3)·10 ¹⁸
в активном слое <i>i</i> -InP, не больше	1·10 ¹⁶
в контактном слое <i>n_k⁺</i> -InP	(1—3)·10 ¹⁸
Подвижность электронов, см ² /(В·с)	>17000 (77 К)
Толщина активного слоя, мкм	1—2
Площадь гетероструктуры, см ² , не меньше	10,0

Для промышленного использования результатов работы планируется разработка базового технологического промышленного процесса производства гетероструктур *n⁺*-InP/*n*-InP для диодов Ганна с дальнейшим внедрением его в серийное производство на технологической базе НПП «Карат».

НИР «Разработка методов выявления и идентификации электрически активных дефектов в полупроводниковых материалах и структурах для создания высоконадежных и конкурентоспособных изделий микроэлектроники», НИИ микроприборов НТК «Институт монокристаллов» НАНУ, г. Киев.

Для выявления электрически активных дефектов (ЭАД) в материалах и технологических структурах на разных технологических этапах изготовления приборов микроэлектроники создан комплекс из пяти специализированных методик:

- 1) выявления и визуализации ЭАД в структурах Si—SiO₂ со сверхтонким диэлектриком при изготовлении интегральных схем;

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

2) выявления локальных источников тепловыделения („горячих точек“) в кристаллах изделий микроэлектроники на основании визуализации локальной холестерической фазы в смектической фазе холестерических жидкых кристаллов;

3) определения ЭАД в приповерхностных слоях кремния, в т. ч. в сверхтонких $p-n$ -переходах, на основе оптического (лазерного) зонда;

4) определения распределения и концентрации ЭАД в технологических МДП-структурках на основе растровой электронной микроскопии;

5) исследования ЭАД в приповерхностном слое кремния в области канала МДП-транзисторов на основе емкостной релаксационной спектроскопии глубоких уровней.

Эти методики внедрены в Центре «Микроанализика» НИИ микроприборов на этапах разработки технологии приборов. Их использование на предприятиях, которые изготавливают изделия микроэлектроники, требующие углубленного контроля технологических структур и процессов, позволит значительно улучшить технико-экономические показатели современных изделий микроэлектроники, повысить их надежность и конкурентоспособность микроэлектронных компонентов [2—5].

НИР «Разработка и исследование технологии получения пленочных катодолюминесцентных структур для дисплеев с высокой разрешающей способностью», НИИ «Гелий», г. Винница.

Предложен и исследован новый способ получения пленочных катодолюминесцентных структур состава ZnS:Cu.Ga и ZnO:Cu.Ga для создания информационных систем высококачественного отображения [6, 7]. Основными этапами разработанной технологии являются электронно-лучевое нанесение в вакууме пленок Zn:Cu и дальнейший их отжиг с одновременным легированием Ga в атмосфере, содержащей серу или кислород.

Технический уровень полученных структур (**табл. 2**) отвечает уровню продукции таких ведущих фирм как Dai Nippon Toryo (Япония), Philips Corporation (Нидерланды), Fataba Denshi Kogyo (Япония).

Разработанная технология получения пленочных катодолюминесцентных структур использована в НИИ «Гелий» в производстве жидкостно-кристаллических индикаторов с повышенной разрешающей способностью.

Таблица 2
Характеристики пленочных катодолюминесцентных структур состава ZnS:Cu.Ga и ZnO:Cu.Ga

Яркость свечения, кд/м ²	до 1000
Плотность тока при ускоряющем напряжении 50 кВ, мкА/см ²	до 70
Цвет излучения	зеленый
Длина волны, нм	520
Площадь образца, см ² , не менее	5,5
Толщина пленок, мкм	6—8
Разрешающая способность, линий/мм, не менее	100

ческих индикаторов с повышенной разрешающей способностью.

Функциональная микроэлектроника

ОКР «Разработка конструкции и технологии изготовления арсенид-галлиевых смесительных и детекторных диодов на кристаллодержателе для радиотехнических устройств диапазона частот (3...80) ГГц», НПП «Сатурн», г. Киев.

Выполнена разработка, а также освоено производство диодов СВЧ, которые не имеют аналогов в странах СНГ [8, 9], что позволит избежать существующих технических и материальных трудностей, связанных с критическим импортом СВЧ-диодов миллиметрового диапазона.

Конструкция диода позволяет использовать его в высокочувствительных детекторных и преобразовательных устройствах как в интегральном (планарном), так и в волноводном варианте реализации. Повышение рабочей частоты диодов до 80 ГГц достигнуто за счет снижения паразитных параметров (емкости и индуктивности), а также потерь на скин-эффект путем выполнения кристалла СВЧ-диода в виде планарной меза-структурь с балочными выводами, смонтированными непосредственно на металлических выводах пленочного кристаллодержателя.

Жизнеспособность и стойкость диодов к внешним воздействиям — климатическим, механическим и другим (при работе в составе гибридных интегральных схем и микросборок радиотехнических приборов объемного исполнения) — обеспечивают возможность их эксплуатации в соответствии с ОСТ 11336.925-81.

По своим техническим характеристикам (**табл. 3**) разработанный диод отвечает уровню лучших современных российских аналогов, а именно смесительных диодов СВЧ ЗА123 и СВЧ ЗА117-6; детекторного диода НВЧ ЗА206-6.

Таблица 3
Технические характеристики диода СВЧ АРКА.432131.002 (ТУ В 32.1-14308747-20:2009)

Емкость диода, фФ, не больше	120
Емкость кристаллодержателя, фФ, не больше	70
Показатель идеальности ВАХ, не больше	1,2
Последовательное сопротивление потерь, Ом, не больше	8
Обратный ток при напряжении 3В, мкА, не больше	5
Габаритные размеры, мм, не больше	1,5×1,5×1,5
Масса образца, г, не больше	0,02

НИР «Разработка и исследование видеомониторов на плоских ЖК-панелях для авиационной техники», НИИ «Гелий», г. Винница.

Разработаны конструкция и технология изготовления экспериментальных образцов видеомониторов на жидкокристаллических панелях с широким рабочим температурным диапазоном и повышенной механической стойкостью (**табл. 4**) [10, 11].

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Таблица 4
Основные параметры экспериментальных образцов видеомониторов

Габаритные размеры, мм	265×198×56,2
Масса, кг	2,2
Размер экрана по диагонали, дюйм, не менее количество пикселов	10,4 1024×768
Потребляемая мощность, Вт, не более	90
Температурный диапазон, °C	от -40 до +55
Напряжение питания, В	27
Угол обзора, градус по вертикали по горизонтали	от -10 до +35 от -50 до +50
Яркость изображения, кд/м ² , в режиме дневном, не менее ночном, не более	800 15

Использование таких видеомониторов в авиационной технике позволит значительно уменьшить вес и габариты бортовой аппаратуры, что повышает летные качества авиационного транспорта.

Энергетическая микроэлектроника

НИОТР «Разработка высокоеффективных концентраторных солнечных батарей на основе соединений A₃B₅», НПП «Карат», г. Львов.

Разработана новая отечественная технология изготовления высокоеффективных гетероструктур GaAs/InGa/AlGaAs для работы при концентрированных (до 500 раз) световых потоках. На основе полученных гетероструктур изготовлен опытный образец модуля солнечной батареи с концентраторами солнечной энергии и высокоеффективной системой отвода тепла с тепловыми трубами [12, 13]. Его КПД достигает 28%, что соответствует мировому уровню. На основе разработанных модулей могут быть созданы концентраторные солнечные батареи, предназначенные для работы в составе высокоеффективных автономных систем энергообеспечения жилых и бытовых помещений, комбинированных систем уличного освещения, подсветки дорожных знаков и т. п.

ОКР «Разработка и внедрение высокоеффективных микроэлектронных элементов для энергосберегающих источников света с целью улучшения эксплуатационных характеристик», НИИ «Гелий», г. Винница.

Разработаны микроэлектронные элементы для дуговых электродов [14, 15] энергосберегающих источников света — дуговых ртутных ламп высокого давления с люминофорным покрытием [16], которые пригодны для работы в светильниках внешнего освещения и освещения производственных помещений. Внедрение в технологию изготовления дуговых электродов РАЛС 657719.008 с высокоеффективными микроэлектронными элементами позволяет увеличить продолжительность горения ламп до 5200 ч, что на 900 ч выше, чем для ламп-аналогов, при этом сни-

жение светового потока за время эксплуатации не превышает 20%.

Результаты ОКР будут использованы на Заводе газоразрядных ламп при серийном производстве ламп высокого давления типа ДРЛ 250 на основе дуговых электродов с высокоеффективными микроэлектронными элементами, которые уже поставляются в необходимых количествах НИИ «Гелий».

В рамках направления «Энергетическая микроэлектроника» проводятся следующие исследования, направленные на повышение эффективности теплоотвода в микроэлектронной аппаратуре.

НИР «Разработка конструкции и исследование технологических особенностей создания и рабочих характеристик крупноформатных термоэлектрических модулей с тепловыми трубами», Институт термоэлектричества НАНУ, г. Черновцы.

Для улучшения рабочих характеристик крупноформатных термоэлектрических модулей отрабатывается конструкция и технологические особенности создания экспериментальных образцов крупноформатных термоэлектрических модулей с тепловыми трубами в зонах подвода и отвода теплоты. Проведенные исследования основных рабочих характеристик таких модулей показали эффективность предлагаемой конструкции в сравнении с традиционными модулями тех же размеров без тепловых труб.

НИР «Исследование и разработка высокоеффективных теплообменников для мощных микропроцессоров», КНУСА, г. Киев.

Для проведения исследований изготовлены экспериментальные образцы водяных теплообменников с повышенной эффективностью [17] для отвода теплоты от мощных микропроцессоров (**табл. 5**).

Таблица 5
Основные технические характеристики экспериментальных образцов теплообменников

Плотность теплового потока на поверхности имитатора микропроцессора, Вт/см ²	от 20 до 100
Количество отводимой теплоты, Вт	от 60 до 600
Максимальная температура поверхности имитатора микропроцессора при температуре воды на входе в теплообменник 25°C, °C	+65
Гидродинамическое сопротивление теплообменника по воде, не более, кПа	6
Габаритные размеры (без учета длины штуперов), не более, мм	55×55×20

НИР «Исследование теплопередающих свойств металлических подложек с замкнутым испарительно-конденсационным циклом для отвода тепла от тепловыделяющих элементов микроэлектронной аппаратуры», НПП «Карат», г. Львов.

Исследуется возможность эффективного отвода тепла от тепловыделяющих микроэлектронных элементов электронного блока [18] при их установке на охлаждающую пластину блока. Проводятся исследования для пластин размерами до 170×280 мм из различ-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ных материалов — меди, алюминия, титана или их сплавов при использовании в качестве теплоносителя воды, этанола или ацетона. Максимальная температура поверхности блока в зоне установки элементов составляет +70°C, плотность теплового потока в зоне теплоподвода — до 5 Вт/см².

Сенсоэлектроника

НИР «Разработка и исследование наноструктурированных пленок чувствительных элементов сенсоров влажности», НИИ «Гелий», г. Винница.

Впервые в Украине создана наноструктурированная композитная пленка [19] для практической разработки и производства интегральных сенсоров влажности [20] с высокой чувствительностью, стабильными во времени характеристиками, с линейной зависимостью емкости от относительной влажности практически во всем диапазоне изменения последней (от 3 до 100%). Такие сенсоры сохраняют работоспособность при низких температурах, вплоть до -35°C, что на данный момент невозможно обеспечить другими существующими материалами (пленки оксидов некоторых металлов, органические пленки и т. п.).

Полученные чувствительные элементы будут использованы в НИИ «Гелий» при изготовлении сенсоров влажности с функциональными параметрами для потребностей гидрометеорологии, медицины, промышленности, агропромышленного комплекса и бытовой электроники.

НИР «Разработка и исследование унифицированного акустоэлектронного преобразователя для сенсоров физических величин», Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

Разрабатывается унифицированный преобразователь на поверхностных акустических волнах — базовый элемент сенсоров целого ряда функциональных назначений [21]. Благодаря использованию достижений акустоэлектроники в разработанном унифицированном преобразователе существенно упрощается электрическое сопряжение сенсора с микропроцессорной техникой. Это обеспечит решение проблемы интеллектуализации сенсора и повышения метрологических и эксплуатационных характеристик.

Преобразователь состоит из чувствительного элемента и электронной схемы первичной обработки электрического сигнала, конструктивно выполненных в одном корпусе. Работа преобразователя исследуется на примере разработанного экспериментального образца сенсора угла поворота (**табл. 6**).

Таблица 6

Основные технические характеристики экспериментального образца сенсора угла поворота

Вид исходного сигнала	частотный
Диапазон рабочих частот, МГц	15,7—16,3
Угол поворота	40°
Погрешность измерения угла, не более	2'
Напряжение питания, В	10±1

Новое технологическое оборудование для микроэлектроники

ОКР «Разработка аппаратуры и технологии термоэлектротренировки сверхмощных лавинно-пролетных диодов 8-миллиметрового диапазона импульсного режима работы», НИИ «Орион», г. Киев.

Впервые в СНГ создан стенд (см. **табл. 7**) для термоэлектротренировки импульсных лавинно-пролетных диодов (ЛПД) для диагностического обеспечения производства мощных кремниевых ЛПД миллиметрового диапазона [22] и технология термоэлектротренировки диодов на этом стенде.

Таблица 7
Основные технические характеристики стенд

Диапазон импульсного рабочего тока, А	5—22
Длительность импульса, нс	100—340
Диапазон напряжения импульса, В	10—70
Температура корпуса диода, °C	20—100
Количество диодов, тестируемых одновременно, шт.	24

Внедрение стендла в НИИ «Орион» обеспечило повышение надежности производимых супермощных кремниевых ЛПД 8-мм диапазона, что позволило укрепить свои позиции на международном рынке.

НИР «Разработка методов и аппаратуры для диагностики надежности кремниевых сверхмощных импульсных ЛПД», Институт физики полупроводников им. В. Е. Пашикарева НАНУ, г. Киев.

Впервые в Украине разработана аппаратура [23, 24] и методы [25] для предварительной диагностики надежности ЛПД по особенностям их вольт-амперной характеристики на участке лавинного пробоя в импульсном режиме работы при напряжении до 100 В, токе до 20 А и длительности импульса 100 нс.

В комплексе с разработанной в НИИ «Орион», г. Киев, аппаратурой и технологией термоэлектротренировки сверхмощных импульсных ЛПД 8-мм диапазона они позволяют получать более полную информацию о параметрах таких ЛПД и ускорить процесс оптимизации технологического процесса производства за счет экспресс-диагностики.

НИР «Исследование способов увеличения времени жизни плазменных образований», НИИ «Гелий», г. Винница.

При использовании электрических разрядов в свободной атмосфере получены автономные долгоживущие плазменные образования с временем жизни 2 с, что соответствует мировому уровню. Разработаны рекомендации по созданию нетрадиционных источников энергии [26].

НИОКР «Разработка малогабаритного ВЧ-диодного реактора с распределенным напуском и откачкой газа для процессов плазмохимического травления с высокой равномерностью», Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина.

Осуществляется разработка и изготовление экспериментального образца малогабаритной малоэнер-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Таблица 8

Давление газа в зоне обработки, Па	1—500
Диаметр зоны обработки, мм, не менее	100
Диапазон энергии ионов, эВ	20—500
Максимальная скорость травления Si, мкм/мин	2—3
Однородность травления, %, не хуже	2
Работа с химически-активными радикалами	C _n F _m , O, N, F
Продолжительность работы (смесь Ar+O ₂ +CF ₄)	
беспрерывной, ч, не менее	8
без профилактики, ч, не менее	40
ВЧ-мощность, Вт	
номинальная	100
максимальная	300
Габаритные размеры (без вакуумного насоса), мм, не более	500×500×300

гоемкой настольной установки с ВЧ-диодным реактором для плазмохимического травления [27] с соблюдением условий высокой равномерности, основные технические характеристики которого приведены в табл. 8.

Планируется проведение испытаний экспериментального образца реактора с целью исследования процессов формирования потоков заряженных частиц, физических принципов согласования импедансов ВЧ-генератора и плазмохимического реактора диодного типа.

НИОКР «Разработка универсального источника ионов для малоэнергоемкого ионно-радикального травления материалов микроэлектроники на базе комбинированного индукционно-емкостного ВЧ разряда», Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина.

Осуществляется разработка универсального источника ионов на базе индукционного разряда с высокочастотной диодной ионно-оптической системой, обеспечивающей независимое управление энергией и плотностью потока ионов при условии полной токовой компенсации, пригодного для малоэнергоемкого ионно-радикального травления материалов микроэлектроники. Проводятся исследования процессов формирования потоков заряженных частиц в условиях токовой компенсации с независимым управлением энергией и плотностью потока ионов, а также физических принципов согласования импедансов высокочастотного генератора и источника ионов.

Источник ионов предназначен для внедрения в современных ионно-плазменных технологиях на предприятиях микроэлектроники Украины.

Интегральные схемы и полупроводниковые приборы

ОКР «Разработка микросхемы четырехканального микромощного операционного усилителя с полевыми транзисторами на входе», НПО «Кристалл», г. Киев

Создана интегральная микросхема четырехканального микромощного операционного усилителя с по-

Таблица 9

Технические характеристики интегральной микросхемы

Скорость нарастания исходного сигнала, В/мкс	9
Полоса частот, МГц	4
Входной ток, пА	10
Коэффициент усиления напряжения	40×10 ³
Ток питания, мкА/канал	210
Напряжение питания, В	от ±4,5 до ±18

левыми транзисторами на входе, характеристики которой (см. табл. 9) полностью соответствуют микросхеме OP482 фирмы “Analog Devices”, США [28, 29]. Впервые в СНГ разработана совместная биполярная технология изготовления полевых транзисторов и плечевых резисторов с изоляцией встречносмещенными *p*—*n*-переходами. При проектировании применена двухуровневая металлизация и функциональная подгонка напряжения смещения нуля методом испарения плавящихся алюминиевых перемычек.

Микросхема предназначена для применения в активных RC-фильтрах, интеграторах, измерительных усилителях, детекторах и других устройствах радиоэлектронной аппаратуры. Начиная с 2010 г. организовано серийное производство микросхем четырехканального микромощного операционного усилителя с полевыми транзисторами на входе УФ1101УД48 (в корпусе SO-14) и УР1101УД48 (в корпусе DIP-14) для потребностей предприятий Национального космического агентства Украины. На 2010 год запланировано изготовление этих микросхем в количестве соответственно около 37 и 10 тыс. шт.

ОКР «Разработка БИС для микроэлектронного координатно-чувствительного детектора (МКЧД) для приборов элементного анализа веществ», НИИ микроприборов НТК «Институт монокристаллов» НАНУ, г. Киев.

Разработана специализированная большая интегральная схема [30, 31] для аналитического приборостроения, которая по своему техническому уровню является лучшей в Украине и соответствует техническому уровню аналогичных микросхем, выпускаемых в России и Белоруссии. Изготовлена и испытана опытная партия микросхем.

Внедрение микросхемы планируется в ОАО «СЕЛМИ» и Институте прикладной физики НАНУ, г. Сумы, в перспективном приборе для анализа состава многоэлементных веществ в реальном масштабе времени.

*НИР «Разработка физико-технологических основ производства мощных быстродействующих высоковольтных 4HSiC *p*—*i*—*n*-диодов», НИИ «Орион», г. Киев.*

Созданы научно-технологические основы для практической разработки и серийного производства мощных быстродействующих высоковольтных (до 1000 В) карбид-кремниевых СВЧ *p*—*i*—*n*-диодов с диапазоном рабочей частоты до 40 ГГц при температуре до 400°C [32—35], серийного производства кото-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

рых в данное время в мире нет. Использование таких диодов позволит создать новое поколение СВЧ мощных коммутирующих устройств, быстродействие которых будет в 3—5 раз выше в сравнении с устройствами на кремниевых $p-i-n$ -диодах, с рабочей температурой до 300°C.

НИР «Исследование и разработка технологии изготовления диодов Ганна 3-мм диапазона с повышенными энергетическими характеристиками на основе фосфида индия», НИИ «Орион», г. Киев.

Впервые в СНГ разработаны базовые научные и конструкторско-технологические решения, обеспечивающие создание диодов Ганна из фосфида индия с повышенными энергетическими характеристиками с толщиной активного слоя 1,5—2,0 мкм в металлорубиновых и металлокварцевых корпусах с диапазоном частот 90—140 ГГц [36, 37]. На данном этапе изготовлены экспериментальные образцы диодов Ганна с катодным контактом, инжектирующим горячие электроны, и исследованы их СВЧ-характеристики. Далее планируется проведение ОТР по созданию серийного производства диодов Ганна 3-мм диапазона с повышенными энергетическими характеристиками на основе фосфида индия для новейших систем связи, навигации, радиолокации, медицины и аппаратуры специального назначения.

ОКР «Разработка конструкции и технологии изготовления сверхмощных до 30 Вт кремниевых лавинно-пролетных диодов 8-мм диапазона импульсного режима работы», НИИ «Орион», г. Киев.

Проводится разработка элементов гибридных СВЧ интегральных схем нового поколения для генерации и усиления СВЧ-мощности минимум до 30 Вт в импульсном режиме (продолжительность импульса рабочего тока — 100—280 нс, паузы между импульсами — 10—200 мкс) в диапазоне частот 33—35 ГГц

Таблица 10

Основные технические характеристики интегральной схемы

Номинальное значение напряжения питания, В	+5,0
Допустимые отклонения напряжения питания, %	±5
Исходное напряжение высокого уровня, не менее, В	-0,5
Исходное напряжение низкого уровня, не более, В	0,4
Входной ток низкого уровня по выводу IN, мкА, не менее	5—100
Исходный ток просачивания при низком уровне напряжения на выводе IN (режим «выключено»), мкА	-10,0—10,0
Динамический ток потребления, мА при $C_L=15$ пФ в диапазоне частот	
от 1,0 до 19,999 МГц, не более	15
от 20,0 до 34,999 МГц, не более	20
от 35,0 до 70,0 МГц, не более	30
Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до +85

[38] для применения в системах связи, радиолокации, навигации и аппаратуре специального назначения. Разработана рабочая конструкторская и технологическая документация для обеспечения гибкого производства сверхмощных кремниевых лавинно-пролетных диодов 8-мм диапазона импульсного режима работы.

ОКР «Разработка высокочастотных КМОП интегральных схем для генераторов с кварцевой стабилизацией частоты», НИИ микроприборов НТК «Институт монокристаллов» НАНУ, г. Киев.

Создается интегральная схема [39] для генерирования электрических импульсов в диапазоне частот от 1 до 70 МГц с подсоединением кварца на соответствующую частоту к КМОП ИС, а также управление входными напряжениями от ТТЛ интегральных схем наличием или отсутствием электрических импульсов на выходе интегральной схемы (табл. 10).

На протяжении 2007—2009 годов в рамках Государственной программы развития промышленности на 2003—2011 годы в области микроэлектроники выполнено 15 работ. Еще 8 работ, начатых в этот период, планируется завершить в 2010 году. По результатам разработок и исследований подано 23 заявки на выдачу патентов Украины на изобретения и полезные модели, по которым на данное время уже получено 11 патентов, рассмотрение других заявок продолжается. Опубликовано 20 научно-технических статей в специализированных изданиях Украины и сделано 11 докладов на международных научно-технических конференциях.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Круковський С. І. Легування рідкісноземельними та ізовалентними елементами / Автореф. дис. ...д. т. н.— Львівська політехніка.— 2005.

2. Попов В. М., Клименко А. С., Поканевич А. П. Усовершенствованный метод выявления «горячих точек» в изделиях микроэлектроники // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2008.— № 3.— С. 55—58

3. Попов В. М., Шустов Ю. М., Клименко А. С., Поканевич А. П. Влияние облучения кремния низкоэнергетическими ионами аргона на образование в нем электрически активных дефектов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2009.— № 4.— С. 48—51.

4. Заявка № а2008 14889 від 24.12.2008 р на видачу патенту України. Спосіб виявлення локальних електрично активних дефектів на поверхні напівпровідника в структурах «метал-діелектрик-напівпровідник» // ДП «НДІ мікроприладів» НТК «Інститут монокристалів» НАН України / В. М. Попов, А. С. Клименко, О. П. Поканевич.

5. Заявка № а2008 13387 на видачу патенту України. Пристрій для візуального відображення електричних потенціалів і температури на поверхні кристала інтегральної мікросхеми // В. М. Попов, А. С. Клименко, О. П. Поканевич.

6. Патент 39999 України. Спосіб створення пілківкових катодолюмінофорів» // ДП НДІ «Гелій» / В. В. Севастьянов, Л. Ф. Коваленко, В. С. Хомченко та ін.— 2009.— Бюл. № 6.

7. Коваленко Л. Ф., Севастьянов В. В., Хомченко В. С., Циркунов Ю. А. Получение эффективных катодолюминесцентных структур на базе пленочной технологии // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2008.— № 6.— С. 48—49.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

8. Патент 40563 України. Напівпровідниковий НВЧ-діод на кристалотримачі // ВАТ «НВП «Сатурн» / В. В. Ткаченко, Е. М. Глущенко, М. І. Угрін, С. В. Бобженко.— 2009.— Бюл. № 7.
9. Ткаченко В. В., Ижко Н. С., Угрин М. И. Арсенид-галлиевые диоды на кристаллодержателе для детекторов 5- и 8-мм диапазонов длин волн // Техника и приборы СВЧ.— 2008.— № 1.— С. 50—51.
10. Патент 39400 України. Резистивний нагрівач активно-матричного рідкокристалічного дисплея // ДП НДІ «Гелій» / Л. Ф. Коваленко, В. С. Хомченко, И. Ю. Жураковский та ін.— 2009.— Бюл. № 4.
11. Коваленко Л. Ф., Жураковский И. Ю., Сташевский В. В., Севастьянов В. В. Жидкокристаллические мониторы для авиационной техники // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2009.— № 3.— С. 32—34.
12. Патент 43132 України. Спосіб отримання гетероструктури з варізонною активною областю // НВП «Карат» / М. М. Ваків, С. І. Круковський, Н. Я. Сиворотка.— 2009.— Бюл. № 15.
13. Ваків Н. М., Круковський С. І., Николаєнко Ю. Е. и др. Технология и конструкция модуля солнечных батарей на основе соединений A_3B_5 с концентраторами солнечной энергии и высокоеффективной системой теплоотвода // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2010.— № 2.— С. 10—13.
14. Севастьянов В. В., Шутовський В. В. Высокоэффективные катодные элементы для газоразрядных источников света // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2009.— № 1.— С. 59—60.
15. Патент 45837. Спосіб виготовлення дугових електродів для газорозрядних ламп високого тиску // ДП НДІ «Гелій» / В. В. Севастьянов, В. В. Шутовський, М. М. Когут, В. І. Давиденко.— 2009.— Бюл. № 22.
16. Заявка № а2008 11840 від 06.10.2008 р. на видачу патенту України. Спосіб виготовлення газорозрядної лампи високого тиску // ДП НДІ «Гелій» // В. В. Севастьянов, В. В. Шутовський, М. М. Когут.
17. Патент 48048 України. Рідинна система охолодження потужного електронного компонента // КНУБА / Е. С. Малкін, Ю. Є. Ніколаєнко, І. Е. Фуртат, М. І. Д'ячков.— 2010.— Бюл. № 5.
18. Патент № 40635 України. Електронний блок // НВП «Карат» / Ю. Є. Ніколаєнко, О. О. Циганський.— 2009.— Бюл. № 8.
19. Коваленко К. Л., Шаран Н. Н., Севастьянов В. В. Наноструктурированная композитная пленка для сенсоров влажности // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2009.— № 5.— С. 49—50.
20. Заявка № u2009 03672 від 15.04.2009 р. на видачу патенту України. Інтегральний сенсор вологості // ДП НДІ «Гелій» / К. Л. Коваленко, М. М. Шаран, В. В. Севастьянов.
21. Лепих Я. И. Датчик угла поворота генераторного типа с элементом на поверхностных акустических волнах // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2009.— № 3.— С. 24—25.
22. Заявка № а 2008 14794 від 22.12.2008 р. на видачу патенту України. Пристрій для випробувань НВЧ напівпровідникових діодів // ДП НДІ «Оріон» / М. С. Болтовець, Г. М. Веремійченко, В. Г. Ноенко та ін.
23. Патент 43386 України. Апаратура для діагностики надійності напівпровідниківих надпотужних і імпульсних лавино-пролітних діодів (ЛПД) // ІФН ім. В. С. Лашкарьова / О. Є. Беляєв, М. С. Болтовець, Р. В. Конакова та ін.— 2010.— Бюл. № 2.
24. Кудрік Я. Я., Шинкаренко В. В. Импульсный характеристиограф // Техника и приборы СВЧ.— 2009.— № 2.— С. 60—61.
25. Кудрік Я. Я. Измерения ВАХ импульсных кремниевых ЛПД на участке лавинного пробоя // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2009.— № 5.— С. 32—33.
26. Патент 40035 України. Пристрій для отримання плазмових згустків // ДП НДІ «Гелій» / В. В. Севастьянов, М. М. Когут.— 2009.— Бюл. № 6.
27. Дудин С. В., Рафальский Д. В. Закономерности формирования пучка ионов низкой энергии при помощи односеточной ионно-оптической системы // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2009.— № 6.— С. 42—45.
28. Рисін В. С., Ткаченко В. О., Сапон С. В. Чотириканальний мікропотужний операційний підсилювач з польовими транзисторами на вході // CHIP NEWS Украина.— 2008.— № 6.— С. 72—82.
29. Свідоцтво про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми / В. О. Ткаченко, В. С. Рисін, В. І. Захаренко, С. В. Сапон.— 2008.— Бюл. № 10.
30. Заявка № а2008 13628 від 25.11.2008 р. на видачу патенту України. Мікроелектронний координатно-чутливий детектор масспектрометра // ДП «НДІ мікроприладів» НТК «Інститут монокристалів» НАН України / О. І. Борискін, В. Г. Вербицький, О. М. Забродіна та ін.
31. Сидоренко В. П., Вербицький В. Г., Прокофьев Ю. В. и др. СБИС для микроэлектронного координатно-чувствительного детектора приборов элементного анализа материалов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2009.— № 2.— С. 25—29.
32. Патент 43851 України. Напівпровідниковий р-i-n надвикочастотний діод // ДП НДІ «Оріон» / В. В. Басанець, М. С. Болтовець, Г. М. Веремійченко та ін.— 2009.— Бюл. № 17.
33. Болтовець Н. С., Борисенко А. Г., Іванов В. Н. и др. Формирование меза-структур 4HSiC p-i-n-диодов методом ионно-плазменного травления // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2009.— № 5.— С. 45—48.
34. Заявка № а2009 04954 від 19.05.2009 р. на видачу патенту України. Омічна контактна система для напівпровідникових приладів з карбіду кремнію // ДП НДІ «Оріон» / В. В. Басанець, М. С. Болтовець, Г. М. Веремійченко та ін.
35. Belyaev A. E., Boltovets N. S., Ivanov V. N. at al. Heat-resistant barrier and ohmic contacts based on TiB_x and ZrB_x interstitial phases to microwave diode structures // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.— 2008.— Vol. 11, N 3.— P. 209—216.
36. Заявка № u2009 10362 від 13.10.2009 р. на видачу патенту України. Діод Ганна з фосфіду індія // ДП НДІ «Оріон» / О. Є. Беляєв, Р. В. Конакова, Я. Я. Кудрік та ін.
37. Іванов В. Н., Ковтонюк В. М., Раєвская Н. С., Ніколаєнко Ю. Е. Особенности технологии и конструирования InP-диодов Ганна // Техника и приборы СВЧ.— 2009.— № 1.— С. 31—33.
38. Заявка № а 2009 12890 від 11.12.2009 р. на видачу патенту України. Лавинно-пролітний діод з термостійкою контактною системою // ДП НДІ «Оріон» / М. С. Болтовець, Г. М. Веремійченко, Т. В. Коростинська та ін.
39. Заявка № а2009 13089 від 16.12.2009 р. на видачу патенту України. Високочастотна КМОН інтегральна схема для генераторів з кварцевою стабілізацією частоти // ДП «НДІ мікроприладів» НТК «Інститут монокристалів» НАН України / В. Г. Вербицький, Т. М. Віроузб, О. Ф. Вощінкін та ін.